

tie 台灣創新技術博覽會 國內最大科研成果展

Taiwan Innotech Expo, TIE

展覽 資訊

時間地點：2026/09/17 (四) - 19 (六) 台北世貿一館
展覽主軸：AI 賦能創新 | 永續邁向未來

尋找潛在供需方 | 跨域及國際鏈結 | 促成技術交易



技術展示

科技論壇

國際合作

媒合商談會

企業導覽

技術移轉

主辦單位：經濟部、國科會、農業部、教育部、國發會、國防部、數發部、勞動部、環境部、衛福部、中研院

2025 博覽會年度成果

442家
參展機構

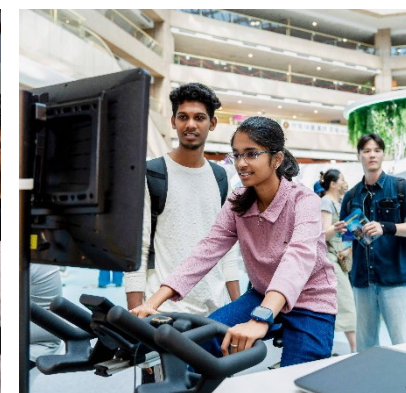
19 國
國際機構

2,800 案
技術洽談


1,110 項
創新技術

50,000
觀展人次

台灣創新技術博覽會官網 <https://tie.twtm.com.tw/zh-tw>



注意事項

- 請務必依照填寫指示說明逐一將欄位資料填妥，共兩頁。
- 此文件將直接作為技術展品評選文件使用。
- 可參照參展技術申請表內容摘錄填寫。
- 填寫完畢請刪除黃色指示圖案 
- 填寫完成後，與參展技術申請表一併提交給：
工研院 羅小姐 itri537423@itri.org.tw

五大子題，請勾選與展品相關度最高的展示子題與技術領域

技術基本資料

技術名稱	
申請單位	
子題名稱	<input type="checkbox"/> 半導體 <input type="checkbox"/> 智慧製造 <input type="checkbox"/> 精準健康 <input type="checkbox"/> 淨零永續 <input type="checkbox"/> 跨域前瞻
技術領域	<input type="checkbox"/> 資訊與通訊 <input type="checkbox"/> 電子與光電 <input type="checkbox"/> 材料化工與奈米 <input type="checkbox"/> 生技與醫療 <input type="checkbox"/> 機械與系統 <input type="checkbox"/> 能源與環境 <input type="checkbox"/> 生活應用 <input type="checkbox"/> 農業相關
技術簡介	<p>微軟正黑體 / 字級16以上 / 約150字。請以淺顯易懂、平易近人方式描述 技術特色、功能、與現有市場產品技術或服務模式之不同之處、預計解決問題等。可參照您於參展技術申請表所填內容摘錄呈現。</p>
技術成熟度	<input type="checkbox"/> 量產上市 <input type="checkbox"/> 試量產 <input type="checkbox"/> 雛型 <input type="checkbox"/> 實驗室階段 <input type="checkbox"/> 概念
供應鏈關係	<ul style="list-style-type: none"> • 上游： • 中游： • 下游： <div style="border: 2px dashed red; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> <p>各舉1個廠商，並描述提供的產品或服務</p> </div>
AI 應用	<input type="checkbox"/> AI硬體 <input type="checkbox"/> AI軟體 <input type="checkbox"/> AI軟硬整合 <input type="checkbox"/> 無
展品互動	<ul style="list-style-type: none"> • 展品互動方式說明

技術說明



產業效益可自行挑選具代表性之數據與文字加以說明。

技術創新

Blank area for technical innovation details.

產業效益

Blank area for industry benefits details.

重大事蹟 / 媒體效益

Blank area for major achievements and media benefits.

亮點關鍵數字

Blank area for key highlights and numbers.

亮點關鍵數字

Blank area for key highlights and numbers.

其他補充說明

▶ 子題名稱

半導體

智慧製造

精準健康

淨零永續

跨域前瞻

▶ AI硬體定義

用於執行 AI 運算工作負載、使用案例或業務工作之所須元件，如 GPU、TPU 或專用晶片等。

▶ AI軟體定義

運行在硬體上的 AI 演算法與程式，涵蓋機器學習框架、數據處理工具及模型應用等。

▶ AI軟硬整合定義

AI 演算法與硬體系統協同設計，實現技術落地與應用效益。

▶ 技術領域

資訊與通訊

電子與光電

材料化工與奈米

生技與醫療

機械與系統

能源與環境

生活應用

農業相關

填寫範例

技術基本資料 (範例)

技術名稱	革命性人形機器人
申請單位	OO機器人超棒棒股份有限公司
子題名稱	■智慧製造
技術領域	■機械與系統
技術簡介	具備 AI 軟硬整合能力之人形機器人系統，已通過 IEC 61508 功能安全標準與 ISO 10218 機器人安全規範相關測試。於實際場域驗證中，雙足行走穩定度達 98% 成功率，連續運作超過 1,000 小時。導入試點後可降低 30% 人力成本、提升 40% 作業效率，並已獲國際系統商採用，展現高度技術成熟度與產業落地潛力。
技術成熟度	■ 量產上市
供應鏈關係	<ul style="list-style-type: none"> • 上游：TSMC先進製程晶片、MediaTek AI 運算平台 • 中游：本機器人所在核心角色 • 下游：鴻海 (Foxconn) 智慧製造場域、統一集團服務應用
AI 應用	■ AI軟硬整合
展品互動	<ul style="list-style-type: none"> • 透過觸控或語音與人形機器人互動，體驗行走、辨識與即時回應能力，並即時觀察 AI 系統運作流程



技術說明 (範例)

技術創新

- 通過ISO/TS15066 (協作機器人碰撞安全) 、 ISO13856-3 (觸覺防護裝置CE認證) ，全球唯一同時通過兩項高門檻國際標準的產品；擁有完整人體碰撞測試報告，通過德國PILZ驗證
- 在5毫秒內感應人體接觸，碰撞力道控制在60–150N的人體容許範圍內，是目前唯一符合所有人體部位測試條件的商用模組

產業效益

- 實際應用於台灣半導體產線，導入製造與服務場域後，可協助企業降低 30% 人力成本，並將高風險作業事故率降低 50% 以上。
- 於試點場域中，單一機器人可取代 2–3 名人力，作業效率提升 40%。
- 預估三年內可帶動超過 新臺幣 20 億元 之相關設備、系統整合與 AI 供應鏈產值。

重大事蹟 / 媒體效益

- 本技術於 2025 年 CES (美國消費性電子展) 首次公開亮相，入選 CES Innovation Awards—Robotics 類別。
- 獲 BBC、Bloomberg 及《經濟日報》 專題報導，並於 COMPUTEX 2025 進行實機展示。
- 其雙足行走穩定度達 98% 成功率，為全球首批完成長時連續運作測試之人形機器人之一。

亮點關鍵數字

前4大

國際機器人
集團採用

亮點關鍵數字

全球No1

家事機器人
市佔

